

## Grinding Technology Japan 2025 出展社一覧 (2025年2月7日現在)

ISBE GmbH / FDPW
株式会社アイゼン
／株式会社リスモツール
／シオンダイヤモンド工業株式会社
株式会社旭商工社
旭ダイヤモンド工業株式会社
株式会社アマダマシンリー
株式会社アライドマテリアル
有限会社アリュース
／ホーコス株式会社
／株式会社イフシタ
アルテックス株式会社
株式会社石川工具研磨製作所
和泉産業株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
入野機工株式会社
宇宙経済新聞合同会社
株式会社宇都宮製作所
AFCジャパン株式会社
／ハイペリオン マテリアルズ アンド テクノロジーズ ジャパン
株式会社エスアンドエフ
／SAV GmbH
NKワークス株式会社
エリコンジャパン株式会社
株式会社オカスギ
株式会社岡本工作機械製作所
株式会社片桐製作所
HENAN ABRASIVESTOCKS TECHNOLOGY CO., LTD
Henan SEPPE TECHNOLOGIES CO., LTD
HENAN KEMEI ABRASIVES CO.,LTD.
Henan Sanhui New Materials Co.,Ltd
Henan HengXin Industrial&Mineral Products Co.,Ltd.
Henan Boreas New Material Co.,Ltd
Henan Hold Diamond Technology Company
Henan Yuxing Carbon Material Co., Ltd
Henan Ruiheng New Material Co., Ltd.
株式会社木村製作所
株式会社キラ・コーポレーション
株式会社きりしま
クール・テック株式会社
株式会社グローバルダイヤモンド
株式会社コイズミツール
株式会社コーショー
株式会社古賀

山水先端技術株式会社
三和クリエーション株式会社
株式会社ジェイテクト
／株式会社ジェイテクトマシンシステム
／株式会社ジェイテクトグラインディングツール
／三井精機工業株式会社
株式会社シギヤ精機製作所
シグマ電子工業株式会社
Journal of Digital Life
Shanxi Taiyue Abrasive Co.,Ltd.
CR GEMS Superabrasives Co., Ltd.
XUCHANG GREAT ABRASIVE CO.,LTD.
株式会社潤滑通信社
株式会社スギノマシン
住友重機械ファインテック株式会社
株式会社スリーエフ技研
セイコーインスツル株式会社
切削フォーラム21
CemeCon株式会社
双龍産業株式会社
ダイナミックツール株式会社
大弥精機株式会社
株式会社太陽工機
ZHENGZHOU JIADING ABRASIVE MANUFACTURING CO., LTD
ZHENGZHOU XIANGYU NEW MATERIAL CO., LTD.
Zhengzhou Xinli Wear-Resistant Material Co., Ltd.
Zhengzhou ZZDM SUPERABRASIVES CO.,LTD
ZHENG ZHOU SILICA NEWMATERIALCO.,LTD
ZHENGZHOU HEYDAY ABRASIVES CO., LTD
Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co., Ltd
Tyrolit Japan KK
ZOLLER Japan 株式会社
株式会社東京精密
株式会社東京ダイヤモンド工具製作所
東昇商事株式会社
東洋研磨材工業株式会社
株式会社トーカロイ
トーマイダイヤ株式会社
株式会社トクビ製作所
トランザーフィルター日本株式会社
DENGFENG WUDU ABRASIVES CO., LTD.
株式会社ナーゲル・アオバプレジジョン
／ELGAN Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG
株式会社ナガセインテグレックス

株式会社ニートレックス
日興キャステイ株式会社
／関西特殊工作油株式会社
日清工業株式会社
日本ダイヤモンド株式会社
日本ハードメタル株式会社
日本RIHON株式会社
二和ダイヤモンド株式会社
浜井産業株式会社
一般社団法人バリ取り・表面仕上げ・洗浄協会
Foshan Huagao Abrasive Co.,Ltd
フォルマー・ジャパン株式会社
福田交易株式会社
二村機器株式会社
プリンクマン・ボンブ・ジャパン株式会社
プロソニック株式会社
株式会社プリリ
株式会社ポイントナイン
株式会社マイスター
牧野フライス精機株式会社
株式会社ミスズ
有限会社三井刻印
株式会社ものづくりレビュー
株式会社ヤマシタワークス
／日本スピードショア株式会社
ユアサ商事株式会社
／株式会社ツガミ
／有限会社サンメンメンテナンス工機
／株式会社ジェイ・シー・シー
／東洋スクリーン工業株式会社
ユニマグテック株式会社
リユーベ株式会社
／株式会社HORIKOSHI
菱高精機株式会社
Luoyang Sunrise Import & Export Trading Co., Ltd.
レッテンマイヤージャパン株式会社

(五十音順)

### 出展対象

- 研削盤
- 研磨盤
- 砥石
- ツルレーイング装置
- 計測機器
- 周辺機器
- 研削工具
- 工具研削盤
- 切削工具
- 切削工具製造技術
- 切削工具活用技術
- 切削油
- 切削油供給装置
- 切削油ろ過装置
- 切削工具素材・材料 他

## SiC,GaN 加工技術展 2025 出展社一覧 (2025年2月14日現在)

アイクリスタル株式会社
アミリアジャパン株式会社
株式会社アライドマテリアル
インサイト株式会社
株式会社荏原製作所
応用物理学会 先進パワー半導体分科会
株式会社オーエステック
株式会社岡本工作機械製作所
オグラ宝石精機工業株式会社
オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
株式会社オプトサイエンス
Guangzhou Summit Crystal Semiconductor Co.
神津精機株式会社
株式会社斉藤光学製作所
株式会社サミットスーパーアプレシブ
三菱工業株式会社
／次世代半導体基板のための実用加工技術検討会
JFEテクノリサーチ株式会社

株式会社ジェイテクトマシンシステム
／株式会社ジェイテクトグラインディングツール
株式会社ジェイテックコーポレーション
SHANDONG JINMENG NEW MATERIAL CO., LTD.
秀和工業株式会社
シンコー株式会社
Zigong Fengrui abrasive Co.,Ltd.
Semi Glory Electronics Materials Co., Ltd.
／LONGTECH PRECISION MACHINERY CO., LTD.
セラミックフォーラム株式会社
つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション
(TPEC、産業技術総合研究所)
株式会社東京精密
株式会社東邦鋼機製作所
日本エクシード株式会社
日本エンギス株式会社
日本セラミラボ株式会社
ノリタケ株式会社
株式会社バイコウスキージャパン

浜井産業株式会社
バリステック工業株式会社
ビュアオンジャパン株式会社
株式会社フォトニククラティス
不二越機械工業株式会社
株式会社フジミンコーポレートッド
合同会社プリマテック
Mipox株式会社
株式会社牧野フライス製作所
ムサシノ電子株式会社
／株式会社ニューメタルズ エンドケミカルズ コーポレーション
株式会社安永
LINSHU DONGSHENG ABRASIVE CO,LTD
レーザーテック株式会社
株式会社レゾナック
六甲電子株式会社
Huai'an Litai Silicon Carbide Micro Powder Co., Ltd

(五十音順)

### 出展対象

- SiC,GaN用インゴットスライシング装置
- SiC,GaN用ウエハ研削装置
- SiC,GaN用研削砥石
- ウエハ端面研削・研磨装置
- SiC,GaN用片面・両面ラッピング装置
- SiC,GaN用CMP装置
- SiC,GaNウエハ専用研磨材スラリー
- ウエハ洗浄システム
- ウエハ形状測定機



**現場の答えが見つかる  
研削加工の専門展示会**

[www.gtj-expo.jp](http://www.gtj-expo.jp)



**2展示会 同時開催**

# SiC, GaN 加工技術展 2025


**先進パワー半導体  
ウエハ加工技術に  
関する専門展示会**

[www.sicgan-expo.jp](http://www.sicgan-expo.jp)

## 2025.3.5(水)～3.7(金) 幕張メッセ

主催 / 日本工業出版 産経新聞

### 開催概要

会 期	2025年3月5日(水)～7日(金) 3日間	開場時間	10:00～17:00
会 場	幕張メッセ 展示ホール8 (〒261-0023 千葉市美浜区中瀬2-1)		
入 場 料	無料(事前登録制)	主 催	 日本工業出版 産経新聞

**名 称** Grinding Technology Japan 2025

**企 画** 日本工業出版(株)「機械と工具」編集部

**後 援** 在日ドイツ連邦共和国大使館

**特別協賛** 切削フォーラム21

**特別協力** (公社)砥粒加工学会

**ネットワークパートナー** Grind Tec

**協 賛** 日本工作機械工業会、日本工作機械輸入協会、日本工作機械販売協会、日本鍛圧機械工業会、日本精密機械工業会、日本機械工具工業会、日本工作機器工業会、日本精密測定機器工業会、研削砥石工業会、ダイヤモンド工業協会、日本光学測定機工業会、日本フルードパワー工業会、日本試験機工業会、日本歯車工業会、精密工学会、日本フルードパワーシステム学会、ターボ機械協会、日本機械鋸・刃物工業会、全国機械用刃物研磨工業協同組合、日本包丁研ぎ協会、バリ取り・表面仕上げ・洗浄協会

**名 称** SiC,GaN加工技術展 2025

**特別協力** (公社)砥粒加工学会  
(公社)応用物理学会 先進パワー半導体分科会

**協 賛** 日本工作機械工業会、日本工作機械輸入協会、日本工作機械販売協会、日本鍛圧機械工業会、日本精密機械工業会、日本機械工具工業会、日本工作機器工業会、日本精密測定機器工業会、研削砥石工業会、ダイヤモンド工業協会、日本光学測定機器工業会、日本フルードパワー工業会、日本歯車工業会、日本機械鋸・刃物工業会、精密工学会、日本フルードパワーシステム学会、ターボ機械協会、SiC アライアンス、GaNコンソーシアム

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、大量の先進パワー半導体が必要になってきました。しかし、これら半導体材料は非常に硬く、高い加工コストが問題となっています。本加工技術展は、それらの課題を持って来場される皆様に、最新の技術・知識で最良の回答を用意しています。



スーパーバイザー 河田研治

## 来場するには

### 来場事前登録

受付期限：会期終了まで



登録フォームから必要事項を入力後、配信されるメールのURLからID、パスワードでマイページにログインしていただき、「入場受付証」をプリントアウトして当日会場にご持参ください。会場にて専用ホルダーに入れ、バーコードチェックを受けてください。

### お問い合わせ

Grinding Technology Japan 2025 / SiC,GaN 加工技術展 2025 展示会事務局(株式会社ティ・シー・エス)  
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-32 芝大門ビル  
TEL : 03-3432-4722 FAX : 03-3432-4730 E-mail : gtj@t-c-s.co.jp / sicgan@sankei.co.jp

※本案内状に記載の事項はやむを得ぬ事情により変更になる場合がございます。最新情報は必ずWebサイトにてご確認ください。(2025年2月7日現在)

3月5日(水) 無料

GTJパネルディスカッション 国際会議場201号室

5-K1 10:30~12:00 『これからの工具づくりと工具研削盤を考える～DX化、自動化への対応』 司会: 株式会社MOLDINO 野洲工場 生産技術部長 佐藤 亮介氏

3月6日(木) 無料

GTJ技術セミナー「研削加工」 国際会議場201号室

5-S1 13:00~13:45 センシングを駆使した加工結果の予測と可視化技術 株式会社ナガセインテグレックス 常務取締役 製造本部 副本部長 技術統括 板津 武志氏

3月7日(金) 無料

GTJ基調講演 国際会議場201号室

7-K1 10:30~11:15 日本の工作機械メーカーが取るべきニッチトップ戦略と産学連携のあり方 日本工作機械メーカーは、その強みとして「中小企業」だが、各社は特定分野で優れた製品・技術を保有し、顧客企業にとって、またその加工プロセスに必要な不可欠な存在として長年に亘り存続してきた。

GTJ技術セミナー「FGS (フレキシブル・グライディング・システム) が拓く新たな研削の世界」 展示会場内特設会場

7-S1 14:00~14:45 工作機械スピンドルの研削加工自動化システム シチズンマシナリー株式会社 生産本部生産技術部 副本部長 小林 勝義氏

砥粒加工学会 ATF2025講演会 有料

10:30~15:50 『ものづくりの30年の変遷と30年後の未来』 主催 公益社団法人 砥粒加工学会 ▶ 申込方法: ATF2025講演会のお申し込みはこちら▶▶▶

製品・技術発表会 無料 展示会場内特設会場

事前申込制 (定員になり次第締め切ります。) ▶ 申込方法: ホームページよりお申し込みください。www.gtj-expo.jp 3月5日(水) 10:30 5-A0 アイクリスタル株式会社 SiC, GaN

SiC, GaNパネルディスカッション 国際会議場201号室

6-K1 10:30~12:00 パワー半導体用大口径SiCウエハの加工技術 - 8インチ量産プロセスのゆくえ- 司会: 株式会社レゾナック デバイスソリューション事業部 SiC技術開発部 GIプロジェクト 加工テーマ サプライダー 伊藤 正人氏

3月7日(金) 有料

公益社団法人 応用物理学会 先進パワー半導体分科会 第28回研究会 国際会議場201号室

「SiC, GaNパワーデバイスの現状ならびに新しい基板加工技術」 12:30~12:35 開会挨拶 12:35~13:05 SiCパワー半導体の現状と今後の展開 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター 研究センター長 田中 保宣氏

砥粒加工学会 展示コーナー 展示会場内特設会場

砥粒加工学会は1957年に砥粒加工研究会と関西砥粒加工研究会を母体として発足し、1995年に法人化、2009年には公益社団法人に認定されました。この間、一貫して砥粒加工技術、工具技術、加工機械、計測技術など、実践的なものづくり技術を総合的にとらえる学会として、参加して「役に立つ学会」、「楽しい学会」として発展してきました。

研削コンシェルジュ 無料 展示会場内「研削コンシェルジュスペース」

事前申込制 (定員になり次第締め切ります。) 5名の専門家が常駐します。特定のメーカーには相談しにくい案件、メーカーではなくアカデミックな方への理論的な疑問など、研削に関するあらゆるお悩みに対応いたします。